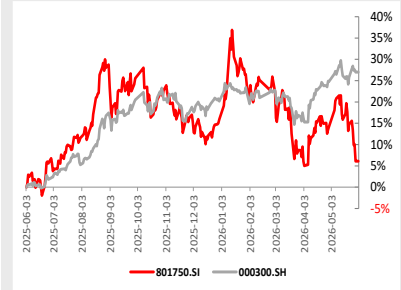


计算机行业周报

看好

市场表现截至

2026.5.29



数据来源: Wind, 国新证券整理

本周计算机行业指数表现

上周(5.25-5.29)计算机(申万)板块下跌7.56%,沪深300指数上涨0.97%,计算机板块跑输沪深300指数8.53个百分点。和申万其他行业对比,计算机行业涨幅排名位列第31位。

上周涨幅前3名分别为*ST易录(42.67%)、真视通(25.66%)、声迅股份(19.90%),跌幅前3名分别为佳华科技(-35.90%)、盛视科技(-26.76%)、思特奇(-24.73%)。

本周关注

- 1、华为发表 τ 定律,实现晶体管密度与系统性能突破
- 2、DeepSeek V4 永久降价 75%后: 登顶全球性价比! 性价比碾压美系旗舰
- 3、三星电子业内率先出样 HBM4E 内存
- 4、IBM 拟投资 100 亿美元,目标 2029 年建成大规模量子计算机
- 5、Anthropic 新一轮融资后估值达 9650 亿美元,超越 OpenAI
- 6、TrendForce: 预估 2027 年全球存储器产值将扩大至 1.28 万亿美元

投资线索

建议 AI 算力等投资机会。

风险提示

- 1、政策落地不及预期;
- 2、技术发展不及预期;
- 3、市场竞争加剧。

分析师: 钟哲元
登记编码: S1490523030001
邮箱: zhongzheyuan@crsec.com.cn

证券研究报告

目录

一、上周市场回顾.....	4
二、上周关注.....	4
1、华为发表 τ 定律，实现晶体管密度与系统性能突破.....	4
2、DeepSeek V4 永久降价 75%后：登顶全球性价比！性价比碾压美系旗舰.....	5
3、三星电子业内率先出样 HBM4E 内存.....	6
4、IBM 拟投资 100 亿美元，目标 2029 年建成大规模量子计算机.....	6
5、Anthropic 新一轮融资后估值达 9650 亿美元，超越 OpenAI.....	7
6、TrendForce：预估 2027 年全球存储器产值将扩大至 1.28 万亿美元.....	8
三、风险提示.....	9

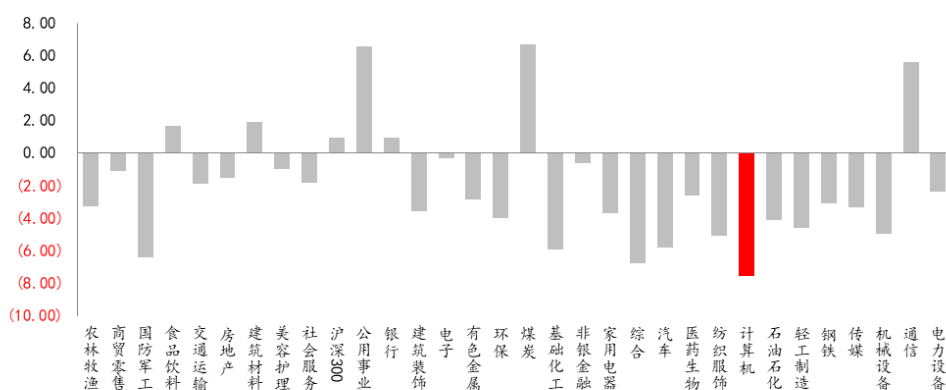
图表目录

图表 1: 计算机行业板块相对表现 (%)	4
图表 2: 计算机行业个股涨跌幅	4

一、上周市场回顾

上周（5.25-5.29）计算机（申万）板块下跌 7.56%，沪深 300 指数上涨 0.97%，计算机板块跑输沪深 300 指数 8.53 个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第 31 位。

图表 1：计算机行业板块相对表现 (%)



数据来源：Wind，国新证券整理

目前计算机行业上市公司共 334 家，其中，21 家公司收涨，占 6.27%。上周涨幅前 3 名分别为*ST 易录（42.67%）、真视通（25.66%）、声迅股份（19.90%），跌幅前 3 名分别为佳华科技（-35.90%）、盛视科技（-26.76%）、思特奇（-24.73%）。

图表 2：计算机行业个股涨跌幅

板块涨幅前三名				板块跌幅后三名			
证券代码	证券简称	细分行业	周涨跌幅 (%)	证券代码	证券简称	细分行业	周涨跌幅 (%)
300212.SZ	*ST 易录	数据要素	42.67	688051.SH	佳华科技	数据要素	-35.90
002771.SZ	真视通	数据要素	25.66	002990.SZ	盛视科技	交运 IT	-26.76
003004.SZ	声迅股份	智能硬件	19.90	300608.SZ	思特奇	数据要素	-24.73

数据来源：Wind，国新证券整理

二、上周关注

1、华为发表 τ 定律，实现晶体管密度与系统性能突破

[中国，上海，2026 年 5 月 25 日] 今日，在电气电子工程师学会（IEEE）举办

的国际电路系统研讨会 ISCAS 2026 上，华为何庭波发表题为“半导体新路径探索与实践”的主旨演讲，发表了指导半导体产业发展的新原则—— τ 定律。 τ 定律提出以“时间(τ)缩微”替代“几何缩微”作为半导体与电子系统演进的新指导原则——通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，从而实现半导体与电子系统的持续演进。

近年来，主导半导体产业半个多世纪的摩尔定律正面临严峻的物理极限和经济效益双重挑战。面对晶体管几何缩微放缓，晶体管成本红利消退等发展困境，如何跨越传统工艺路径的局限，探索出一条全新的可持续演进路线，以满足当下呈指数级攀升的计算性能需求，已成为全球半导体行业亟待攻克共同难题。 τ 定律正是解决该难题的有效路径。

华为创新性地提出了“逻辑折叠(LogicFolding)”等核心技术，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。该体系以系统性降低时间常数 τ 为目标，旨在驱动各层级性能、能效、晶体管密度的持续提升：

器件层面：通过优化晶体管和互连电阻及寄生电容，从物理底层最大限度缩微器件级时间常数 τ ；

电路层面：通过逻辑折叠技术突破传统平面布局的物理边界，显著缩短关键路径的走线长度并有效降低信号传播的电阻和电容负载，实现晶体管密度和电路性能大幅提升；

芯片层面：通过“软件、架构、芯片”的全栈软硬芯协同设计，基于实际工作负载实现指令流和数据流的细粒度控制，提高系统级并行度和效率，大幅降低端到端执行时间；

系统层面：定义灵衢总线，重构计算系统互联协议，实现超节点的统一内存编址和原生内存语义，大幅降低系统通信时延。

在此次主旨演讲中，何庭波详细讲解了华为如何把 τ 定律应用到智能手机和 AI 计算领域的实践。在过去六年的实践中，基于 τ 定律，华为已成功设计并量产了 381 款芯片，广泛覆盖了千行百业的需求。其中，将于 2026 年秋季面世的麒麟芯片，率先采用了逻辑折叠技术，性能大幅提升。预计到 2031 年，基于 τ 定律的高端芯片晶体管密度将达到 1.4 纳米制程的同等水平。

面对未来，何庭波说：“未来一定属于开放合作。在半导体演进的路径上，没有一家企业可以独立完成所有答案。在 τ 定律的路径下，我们期待与全球科学家、工程师和产业伙伴紧密合作，共同推动半导体与电子产业持续发展。”（华为官网）

2、DeepSeek V4 永久降价 75%后：登顶全球性价比！性价比碾压美系旗舰

快科技 5 月 25 日消息，DeepSeek 近日更新 API 文档，宣布 DeepSeek-V4-Pro 模型在 5 月 31 日 2.5 折优惠结束后，将永久降价至原定价的 1/4，相当于降价 75% 后永久保留折扣。

据报道，第三方评估机构分析显示，此次降价将使 DeepSeek-V4-Pro 登上全球 AI 模型性价比榜首。

Artificial Analysis 数据显示，完成该机构的 AI 智能指数基准测试，DeepSeek-V4-Pro 需 268 美元，而 OpenAI GPT-5.5 和 Anthropic Claude Opus 4.7 执行相同任务的成本，分别约为其 12 倍和 19 倍。

除 DeepSeek 外，性价比排名领先的其他 AI 模型大多也来自中国，包括 MiniMax M2.7 和小米 MiMo-V2.5-Pro 等。

具体价格方面，DeepSeek-V4-Pro 输入缓存命中价格为 0.025 元/百万 Tokens，输入缓存未命中 3 元/百万 Tokens，输出 6 元/百万 Tokens。

此前 4 月 26 日 DeepSeek 已将全系列 API 输入缓存命中价格永久降价，V4-Flash 从 0.2 元降至 0.02 元，V4-Pro 从 1 元降至 0.1 元，随后开启的 2.5 折限时优惠如今转为永久定价。

价格大幅下降的同时，DeepSeek-V4-Pro 性能仍接近世界前沿水平，4 月 24 日技术报告显示其 Agent 能力显著增强，Agentic Coding 测评已达当前开源模型最佳水平。

3、三星电子业内率先出样 HBM4E 内存

IT 之家 5 月 29 日消息，三星电子 (Samsung Electronics) 韩国当地时间今日宣布，已开始向全球主要客户交付业界首批 12 层 (12Hi) HBM4E 样品。

三星的 HBM4E 可提供稳定的 14Gbps 引脚传输速度并能扩展至 16Gbps，相较 HBM4 再度提升 20%。其每个堆栈的内存带宽高达 3.6 TB/s，有助于最大限度地提高 LLM 和下一代 AI 系统的计算性能。

与其 HBM4 一样，三星 HBM4E 结合了 1c nm DRAM 裸晶和 4nm 逻辑裸晶。而新的 HBM4E 通过先进的低功耗设计技术和优化的封装结构实现了 16% 的能效提升和 14% 的热阻特性改进。

三星电子的 12Hi HBM4E 单堆栈容量为 48GB，该企业计划根据客户需求后续补充 8Hi 32GB、16Hi 64GB 的配置。在完成初步样品交付和优化后，三星计划根据客户的进度安排开始批量生产 HBM4E。

4、IBM 拟投资 100 亿美元，目标 2029 年建成大规模量子计算机

IT之家5月29日消息，IBM于当地时间周四宣布，计划在未来五年内投资超过100亿美元（IT之家注：现汇率约合679.19亿元人民币）用于量子计算，目标是在2029年前建成第一台能够可靠且无差错运行复杂计算的大规模量子计算机。

IBM拟投资100亿美元，目标2029年建成大规模量子计算机

上周，美国政府宣布将对九家量子计算公司进行20亿美元的股权投资。其中，IBM将获得一半资金，用于一家名为Anderon的新企业。IBM表示，Anderon将成为美国首家专用的量子芯片制造工厂。

IBM拟投资100亿美元，目标2029年建成大规模量子计算机

近年来该领域的技术突破激发了投资者的兴趣，量子计算有望加速从药物发现、金融建模到密码学等多个领域的任务。但主要技术障碍依然存在，包括限制实际应用的高错误率。Alphabet CEO孙达尔·皮柴去年曾表示，“实际可用的”量子计算机还需五到十年时间。

IBM表示其新的投资将涵盖研发、资本支出、生态系统合作、制造规模扩大以及并购。公司向Anderon注资10亿美元（现汇率约合67.92亿元人民币），后者将向外部客户提供其芯片制造技术，并已与潜在客户展开谈判。IBM还承诺向Anderon提供知识产权、资产和员工，并随着新公司的发展引入更多投资者。

IBM拟投资100亿美元，目标2029年建成大规模量子计算机

IBM周四表示，迄今为止已部署超过90套量子系统，超过业内其他公司的总和。根据提交给美国证券交易委员会的文件，超过325家《财富》500强企业、初创公司、大学及政府机构正在使用其量子系统解决化学、生物学和材料科学领域的挑战。受此消息影响，IBM股价在盘前交易中上涨1.7%。

5、Anthropic新一轮融资后估值达9650亿美元，超越OpenAI

人工智能公司Anthropic PBC在新一轮融资中募资650亿美元，投后估值达到9,650亿美元，首次超过竞争对手OpenAI。

这轮融资于周四宣布，由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和红杉资本领投。彭博社援引知情人士消息称，每家领投方的出资额均超过20亿美元。红杉资本拒绝置评。其他三家公司未回应置评请求。

知情人士称，Alphabet Inc.旗下谷歌向这轮融资投入了数十亿美元，这是此前宣布的长期向Anthropic投资最高400亿美元承诺的一部分。Anthropic在一篇博客文章中表示，亚马逊在本轮融资中出资50亿美元，也属于此前承诺的一部分。

谷歌拒绝置评。美光科技、三星电子和SK海力士也有出资，金额未披露，帮助推动本轮融资规模远高于Anthropic最初300亿美元的目标。

这轮大规模融资在短短数周内敲定，显示投资者对这家 Claude 开发商需求强劲。彭博新闻社此前报道，4月下旬，在收到多份融资提案后，Anthropic 一直在权衡是否以超过 9,000 亿美元的估值寻求新融资。随后，这家人工智能初创公司本月早些时候启动深入谈判。

Anthropic 由一群 OpenAI 前员工于 2021 年创立，如今已成为人工智能领域的领军企业。Anthropic 开发了一系列人工智能工具，旨在重塑企业处理从编码到网络安全等任务的方式。预计 Anthropic 和 OpenAI 最早都将在今年秋季上市。一位知情人士称，在最新这轮融资后，预计 Anthropic 仍将按这一时间表推进首次公开募股(IPO)。

Anthropic 拒绝置评。

彭博社此前报道，Anthropic 预计第二季度营收将达到 109 亿美元，环比增长逾 1 倍，因其人工智能软件需求激增。该公司也有望实现首个季度盈利。

知情人士称，该公司已告知投资者，到下月底，其年化营收运行率将超过 500 亿美元。运行率是一项根据较短期间销售额推算全年营收的指标。Anthropic 去年 7 月的运行率为 40 亿美元。

OpenAI 在 3 月完成的上一轮融资中估值为 8,520 亿美元。预计该公司将在未来几天以保密方式提交上市文件草案。(国际财闻汇)

6、TrendForce：预估 2027 年全球存储器产值将扩大至 1.28 万亿美元

智通财经 APP 获悉，TrendForce 表示，AI 发展从大型模型训练转向以推理为核心的 Agentic AI(代理式 AI)应用，驱动存储器需求结构性扩张，由于供给缺口短期无法补足，推升价格上涨。TrendForce 集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估，将 2026 年产值预计提高至 8,893 亿美元，2027 年则预计由 8,427 亿美元上修至逾 1.28 万亿美元，年增率约 44%。

分析 DRAM 需求变化，Agentic AI 系统的推理请求由单次转为持续循环，KV Cache 的容量需求也随 Context Window 等比扩张，若需要重新计算，算力成本将呈指数级成长。因此，高效管理 KV Cache 已成为提升 AI 推理效能的关键，直接带动对 HBM 与 DRAM 的需求。

同时，随着 Agentic AI 工作负载对 CPU 的调度、数据预处理、存储器管理等需求大幅上升，新一代 AI Server(AI 服务器)平台 CPU 与 GPU 配置已由过去约 1:8，逐步提升至 1:4 甚至更高，如 NVIDIA NVL72 机架即采用 1:2 的配置。CPU 用量的增加将扩大 Server DRAM 的配置需求，同步带动采购量与合约价。

此外，HBM 对晶圆耗用量的增加，压缩 Conventional DRAM 可用产能。在需求扩张的情况下，更强化供应商对合约价的话语权，预估可支持涨势至 2027 年。

因此，TrendForce 集邦咨询上调 2026 年 DRAM 产值至 6,187 亿美元，年增率达 303%；预计 2027 年产值将进一步成长至 9,033 亿美元，年增 46%。

观察 NAND Flash 领域，全球九大云端服务供应商(CSP)合计资本支出不断提升，预估 2026 年成长幅度将达 79%，资本密集度也将提高至 34%，反映投资逻辑从“按需扩容”，逐步走向大规模布局 AI 基础设施，以巩固长期优势。其背后的驱动力同样为 Agentic AI，包括 AI Agent(AI 智能体)带动企业端使用量翻倍，如重度使用者的 Token 消耗量暴增至原本的四倍。而媒体生成的复杂度攀升，也大幅增加 Token 消耗量。

面对庞大且持续增加的存储器需求，成本较高的 HBM 难以支撑大规模部署，而 HDD 则受制于存取速度与耗电问题，无法满足 AI 数据中心的实时处理需求，这种情况为 NAND 提供了成长空间，无论是 SCM SSD、HBF，还是 SLC/pSLC SSD，各类高性能 SSD 方案正全面渗透至 AI 推理、训练与代理工作负载的各个层次，成为成长强劲的关键元件。

由于需求强劲但供给紧张，NAND Flash 价格获得支撑，TrendForce 集邦咨询上修 2026 年全球 NAND Flash 产值达 2,706 亿美元，年增高达 280.7%，2027 年更将进一步扩大至近 3,794 亿美元，持续取得 40.2%的年成长。

三、风险提示

- 1、政策落地不及预期；
- 2、技术发展不及预期；
- 3、市场竞争加剧。

投资评级定义

公司评级		行业评级	
强烈推荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 15%以上	看好	预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5%以上
推荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 5%到 15%	中性	预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平
中性	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数变动在-5%到 5%内	看淡	预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5%以上
卖出	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数跌幅在 15%以上		

免责声明

钟哲元，在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。

本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。在本人所知情的范围内，本人所在机构、本人以及本人的利害关系人与本报告所评价或推荐的证券不存在任何利害关系。

国新证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，以下简称本公司）已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。本公司的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策。本报告仅提供给本公司客户有偿使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归本公司所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、建议等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠，但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。本公司及其关联方可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务，敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响。

国新证券股份有限公司市场研究部

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 层（100020）

传真：010-85556155 网址：www.crsec.com.cn